



カバーはオプションです

ホットプレート HT-1370

予熱やリフローはんだ付け、そしてQFPやBGAの修理作業などSMT基板用に開発された、高精度で使いやすいホットプレートです。

特 長

- 作業プレートを装備しているの、加熱後のワークの取扱いが安全で簡単です。
- 使用後の事故を防ぐための安全カバーがあります(オプション)。これにより、高温になっているホットプレートに触れてしまう危険がなくなります。

仕 様

- ホットプレートサイズ 120 × 140mm t=18mm
- ワークプレートサイズ 120 × 140mm
- 適合基板サイズ 最大120 × 140mm
- 使用温度範囲 0～350℃
- 温度精度 ±1%
- 温度制御 PID制御
- ヒーター カートリッジヒーター 300W/120V × 2本
- センサー 熱電対K(CA)
- 立ち上がり時間 8分
20℃→200℃
- 電源 420W/100V, 510W/220V
- 外形寸法 (W)250 × (D)180 × (H)120mm
(カバー装着時 (W)260 × (D)200 × (H)140mm)
- 重量 2.5kg
(カバー装着時 3kg)

用 途

- H-ICや小型SMT基板の予熱やリフローはんだ付け。
- BGA/CSPのRe-b alling。
- 接着剤の熱硬化。
- その他予熱、加熱作業。

※本仕様は予告なく変更することがあります。